制作篇(1)-贴片元件的焊接

今越电子工作室 刘泽民

下图是最新版本(109-02000-00E,亦即网站上发布的版本)的电路板照片,可以看出该示波器大量使用了贴片元件,以求体积小和制作方便。对于贴片元件,可能有不少人仍感到"畏惧",特别是部分初学者,觉得它不象传统的引线元件那样易于把握。这可能与我们目前国内多数电子制作资料仍以引线元件为主有关,但这是一种错觉。在这里我们先谈谈贴片元件的好处,手工焊接需要的工具和基本焊接方法。



贴片元件的好处

贴片元件与引线元件相比有着许多好处。体积小重量轻自不必说,从制作和维修的角度看,贴片元件比引线元件容易焊接,容易拆卸,也容易保存和邮寄。做过的朋友都知道,引线元件的拆卸是比较麻烦的,特别是在两层以上的 PCB 板上,哪怕是只有两只引脚,拆下来也很容易损坏电路板,多引脚的就更不用说了。而拆卸贴片元件就容易多了,不光两只引脚容易拆,即使一、二百只引脚的元件多拆几次也可以不损坏电路板。说到容易保存请看下面的照片,数万只零件可以放在一个夹子里,取放都很方便,若换成相应的引线元件会是怎样?贴片元件的另一个好处是便于替换,因为许多电阻、电容和电感都有相同的封装尺寸,同一个位置可以根据需要装上电阻、电容或电感,增加了设计调试电路的灵活性。贴片元件还有一个很重要的好处,那就是提高了电路的稳定性和可靠性,对于制作来说就是提高了制作的成功率。这是因为贴片元件没有引线,从而减少了杂散电场和杂散磁场,这在高频模拟电路和高速数字电路中尤为明显。可以说,只要你一旦适应和接受了贴片元件,除了不得已,你可能再也不想用引线元件了。



焊接贴片元件需要的工具

对于搞电子制作来说,最关心的是贴片元件的焊接和拆卸。要有效自如地进行贴片元件的焊接拆卸,关键是要有适当的工具。幸好,对于爱好者来说,这些工具并不难找,也不昂贵,下面是一些最基本的工具。

- → 镊子 搞电子制作的都有镊子,但这里要的是比较尖的那一种,而且必须是不锈钢的,这是因为其他的可能会带有磁性,而贴片元件比较轻,如果镊子有磁性则会被吸在上面下不来,令人讨厌。
- ◆ **烙铁** 大家都有烙铁,这里也是要比较尖的那一种(尖端的半径在 1mm 以内), 烙铁头当然要长寿的。烙铁最好准备两把,拆零件是用,虽然本人常只用一把, 也能对付过去,但不熟练的朋友强烈建议还是准备两把。
- ◆ 热风枪 这是拆多脚的贴片元件用的,也可以用于焊接。买专用的比较贵,可能要一、二百元以上,国内有一种吹塑料用的热风枪(下图左边),只售五、六十元,很多卖电子元件的店都有卖,很合用。我测过它吹出热风的温度,可达 400 500 度,足以熔化焊锡。
- ◆ 细焊锡丝 要 0.3mm 0.5mm 的,粗的(0.8mm 以上)不能用,因为那样不容易控制给锡量。





- ◆ **吸锡用的编织带** 当 IC 的相邻两脚被锡短路了,传统的吸锡器是派不上用场的,只要用编织带吸就行了。
- ◆ 放大镜 要有座和带环形灯管的那一种(上图右边),手持式的不能代替,因为

有时需要在放大镜下双手操作。放大镜的放大倍数摇 5 倍以上,最好能 10 倍,但 10 倍的不容易找,而且视场会比较小,视场大的又会比较贵。这种类型的放大镜 售价印象中是不到 100 元,如果能找到适当的放大镜玻璃也可以自己做一个,环形灯管很便宜,本人就做过一个,具体方法将另文介绍。

贴片元件的手工焊接和拆卸

有了上述工具,焊接和拆卸贴片元件就不困难了。对于只有 2-4 只脚的元件,如电阻、电容、二极管、三极管等,先在 PCB 板上其中一个焊盘上镀点锡,然后左手用镊子夹持元件放到安装位置并抵住电路板,右手用烙铁将已镀锡焊盘上的引脚焊好。元件焊上一只脚后已不会移动,左手镊子可以松开,改用锡丝将其余的脚焊好。如果要拆卸这类元件也很容易,只要用两把烙铁(左右手各一把)将元件的两端同时加热,等锡熔了以后轻轻一提即可将元件取下。

对于引脚较多但间距较宽的贴片元件(如许多 SO 型封装的 IC,脚的数目在 6 – 20 之间,脚间距在 1.27mm 左右)也是采用类似的方法,先在一个焊盘上镀锡,然后左手用镊子夹持元件将一只脚焊好,再用锡丝焊其余的脚。这类元件的拆卸一般用热风枪较好,一手持热风枪将焊锡吹熔,另一手用镊子等夹具趁焊锡熔化之际将元件取下。

对于引脚密度比较高(如 0.5mm 间距)的元件,在焊接步骤上是类似的,即先焊一只脚,然后用锡丝焊其余的脚。但对于这类元件由于其脚的数目比较多且密,引脚与焊盘的对齐是关键。在一个焊盘上镀锡后(通常选在角上的焊盘,只镀很少的锡),用镊子或手将元件与焊盘对齐,注意要使所有有引脚的边都对齐(这里最重要的是耐心!),然后左手(或通过镊子)稍用力将元件按在 PCB 板上,右手用烙铁将赌锡焊盘对应的引脚焊好。焊好后左手可以松开,但不要大力晃动电路板,而是轻轻将其转动,将其余角上的引脚先焊上。当四个角都焊上以后,元件基本不会动了,这时可以从容不迫地将剩下的引脚一个一个焊上。焊接的时候可以先涂一些松香水,让烙铁头带少量锡,一次焊一个引脚。如果不小心将相邻两只脚短路了不要着急,等全部焊完后用编织带吸锡清理即可。这些技巧的掌握当然是要经过练习的,如果有旧电路板旧 IC 不妨拿来作练习。

高引脚密度元件的拆卸主要用热风枪,一只手用适当工具(如镊子)夹住元件,另一只手用热风枪来回吹所有的引脚,等都熔化时将元件提起。如果拆下的元件还要,那么吹的时候就尽量不要对着元件的中心,时间也要尽量短。元件拆下后用烙铁清理焊盘。

如果你对自己焊实在没有把握,也可以找人帮忙,现在修手机的到处都是,他们大多有一个热风焊台,而且维修师傅会有一定经验,请他们帮忙(或付些许钱)就解决了你的大问题。

有关贴片元件的手工焊接和拆卸方法网上有不少资料,大家可以找找。本人是近视加老花,开始时还用放大镜,后来干脆什么也不用,眼镜也不带,凭肉眼看得更清楚,只是凑得近点,对于多达 200 只脚的 IC 照样反复拆焊不误。年轻的朋友眼睛好,相信会比我做得更好。